

qualification.

# Final Product/Process Change Notification Document #: FPCN22191XF1

Issue Date: 12 December 2018

Title of Change:	SOIC-8 Insourcing to ON Semiconductor Philippines (OSPI) Factory from GEM (China)		
Proposed first ship date:	Not Applicable		
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < Rodrigo.Milana.Jr@onsemi.com>		
Samples:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < <a href="mailto:PCN.samples@onsemi.com">PCN.samples@onsemi.com</a> > Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change.		
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or	< Lalan.Ortega@onsemi.com>.	
Type of notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change.  ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact < <a href="mailto:PCN.Support@onsemi.com">PCN.Support@onsemi.com</a>		
Change Part Identification:	Product marked with date code 1816 or later may be built from current factory or from OSPI Factory. The trace code marking on Line 2 is of the form ALYW where A = Assembly Location, L = Wafer Lot ID and YW is a 2-digit date code. Product marked with "P" as the assembly location will be from OSPI. Additionally on the label of the box and reel, the ASSY LOC: PO will also indicate product assembled in OSPI. Please see sample label on Page 2 at the following URL http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LABELRM-D.PDF to see the location of the ASSY LOC.		
Change Category:	☐ Wafer Fab Change	▼ Test Change	
Change Sub-Category(s):  ✓ Manufacturing Site Additi  ☐ Manufacturing Site Transform  ☐ Manufacturing Process Ch	er Product specific change	☐ Datasheet/Product Doc change  ✓ Shipping/Packaging/Marking  ☐ Other:	
Sites Affected:	ON Semiconductor Sites: ON Carmona, Philippines	External Foundry/Subcon Sites: GEM Electronics, China	
Description and Purpose:			
This Update Notification is issued to remove following products, FDS4501H, FDS4897C, FDS4935A, FDS6892A, FDS6898A, and FDS6898A-G from FPCN22191XF. These products will not yet undergo the change described in original FPCN22191XF. These products, FDS4897C, FDS4935A, FDS6898A, and FDS6898A-G will be re-aligned to another Qual vehicle to qualify new L/F design. FDS4501H will also be re-aligned to another Qual vehicle to qualify the respective of their respective products.			

TEM001793 Rev. A Page 1 of 2



## Final Product/Process Change Notification Document #: FPCN22191XF1

Issue Date: 12 December 2018

Reliability Data Summary:
See original FPCN22191XF
Electrical Characteristic Summary:
The temperature characterization meet datasheet specification. Electrical characteristics are not impacted. Detail of Electrical characterization result is available upon request.
List of Affected Standard Parts:

Part Number	Qualification Vehicle	
FDS4501H		
FDS4897C		
FDS4935A	FDS6679	
FDS6892A		
FDS6898A		

#### NOTE:

Please be informed that there are Customer Specific parts impacted by this notice, thus MPN & CPN info will not be reflected in the parts list of this Generic document. Instead please click the link to the addendum copy provided in the email notification to see full list of affected products specific to your company.

TEM001793 Rev. A Page 2 of 2

## Japanese translation of the notification starts here. 通知の日本語訳はここから始まります。

**Note**: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注:日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます.



### 最終製品/プロセス変更通知

文書番号: FPCN22191XF1 発行日: 12 December 2018

変更件名:	SOIC-8 についての GEM(中国)から ON Semiconductor Philippines(OSPI)工場へのインソーシング		
初回出荷予定日:	適用できません		
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <rodrigo.milana.jr@onsemi.com> にお問い合わせください。</rodrigo.milana.jr@onsemi.com>		
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < <u>PCN.samples@onsemi.com</u> > にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN、または最終 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。		
その他の信頼性データ:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <lalan.ortega@onsemi.com> にお問い合わせください。</lalan.ortega@onsemi.com>		
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知(FPCN)です。 FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。 お問い合わせは、< <u>PCN.Support@onsemi.com&gt;</u> にお願いします。		
変更部品の識別:	日付コード 1816 以降の製品は、現在の工場または OSPI 工場で製造されています。捺印の 2 行目のトレースコードの様式は ALYW となっており、A は組立拠点、L はウェハロット ID、そして YW は 2 桁の日付コードを示しています。組立拠点が「P」と捺印されている製品は OSPI 品です。また、ボックスとリールに貼られたラベルに ASSY LOC: PO の表記があるものは OSPI で組み立てられた製品であることを示しています。 ASSY LOC の位置について以下の URL にある冊子の 2 ページ目のサンプルラベルをご参照ください。 http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LABELRM-D.PDF		
変更カテゴリ:	□ ウェハファブの変更 □ アセンブリの変更 □ 試験の変更 □ その他		
変更サブカテゴリ:  ▼ 製造拠点の追加  □ 製造拠点の移転  □ 製造プロセスの変更	<ul><li>✓ 材料の変更</li><li>✓ 出荷/パッケージング/表記</li><li>✓ その他:</li></ul>		
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: 外部製造工場または下請け業者拠点: GEM エレクトロニクス、中国		

#### 説明および目的:

このアップデート通知は、以下の製品、FDS4501H、FDS4897C、FDS4935A、FDS6892A、FDS6898A、FDS6898A-G を FPCN22191XF の対象から削除するために発行されました。これらの製品に対して、元の FPCN22191XF に記載された変更は実施されていません。これらの製品、FDS4897C、FDS4935A、FDS6892A、FDS6898A、および FDS6898A-G においては新しいリードフレームを採用するため、また FDS4501H については 2.5um のトップメタルに変更するため、他の認定試験用ビークルにより再度認定試験が実施され、試験の完了後に新たな FPCN が発行されます。

TEM001793 Rev. A 1/2 ページ



### 最終製品/プロセス変更通知

文書番号:FPCN22191XF1 発行日:12 December 2018

[				
信頼性データの要約:				
元の FPCN22191XF を参照				
電気的特性の要約:				
   温度特性はデータシートの仕様を満たしています。電気的特性は影響を受けません。電気的試験結果の詳細は要望に応じて入手できます。 				
影響を受ける部品の一覧:				
部品番号	認定試験用ビークル			
FDS4501H				
FDS4897C				
FDS4935A	FDS6679			
FDS6892A				
FDS6898A				

注:本通知により影響を受ける顧客特定部品があり、よってMPN および CPN 情報は本一般文書の部品リストに反映していないことにご留意ください。代わりに、特に御社に影響する製品の全リストを見るためには電子メール通知で提供される補遺コピーへのリンクをクリックしてください。

TEM001793 Rev. A 2/2 ページ



### **Appendix A: Changed Products**

Product	Customer Part Number	Qualification Vehicle
FDS4501H		FDS6679
FDS4897C		FDS6679
FDS4935A		FDS6679
FDS6892A		FDS6679
FDS6898A		FDS6679